

2011年3月期第2四半期決算説明会資料

～電子デバイスシステムの好調により、業績予想を上方修正～

2010/10/26

◎ 株式会社日立ハイテクノロジーズ

執行役社長 大林 秀仁

Copyright©2010 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved.

2011年3月期第2四半期 決算説明会

I 2011年3月期第2四半期累計期間 決算概要

II 2011年3月期 業績予想

III 参考:データ集

I

2011年3月期第2四半期累計期間 決算概要

(注)YY/MはYY年M月期を表しています。
(e)は、前回予想(2010年7月公表値)

Copyright©2010 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved.

2011年3月期第2四半期累計期間(ハイライト)

(億円)

	当期実績	前年同期比		前回予想比	
		増減額	増減率	増減額	増減率
売上高	3,353	+536	+19%	+123	+4%
営業利益	138	+214	—	+48	+53%
経常利益	143	+213	—	+51	+56%
当期利益	98	+151	—	+36	+58%
一株利益	71円11銭	+109円69銭		+26円03銭	
一株配当	10円00銭	+5円00銭		±00円00銭	
FCF	+87	+152		+39	

* 前回予想(2010年7月公表値)

対前回予想値(2010年7月1Q決算発表時)比較

売上高 (3,230億円 → 3,353億円 +123億円)

■ 科学・医用システム: 医用分析装置の出荷前倒し等により36億円増加

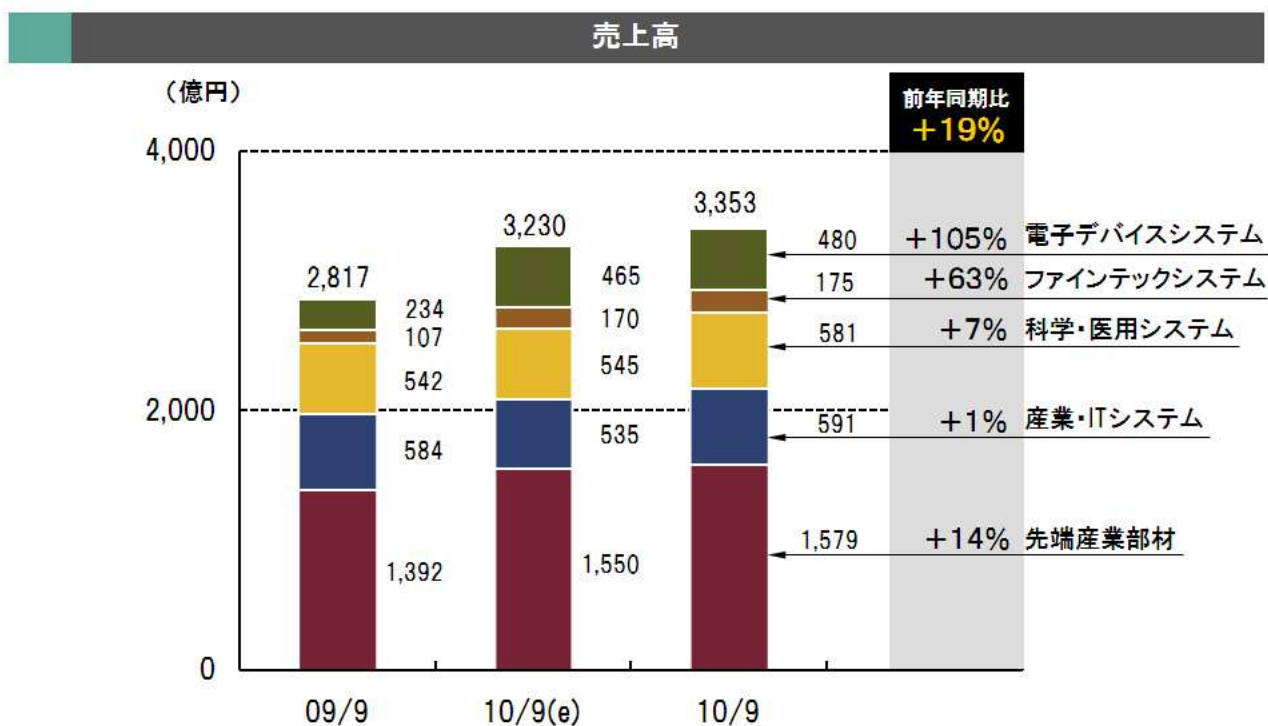
■ 産業・ITシステム: 米国向け携帯電話の売上増等により56億円増加

■ 先端産業部材: 自動車部品の需要増等により29億円増加

営業利益 (90億円 → 138億円 +48億円)

■ 電子デバイスシステム: 半導体後工程装置の売上増および操業度改善等により22億円増加

■ 科学・医用システム: 医用分析装置の出荷増等により15億円増加



(注)合計にはセグメント間の内部取引の消去等が含まれております。

Copyright©2010 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved.

6

■ 前年同期比増減説明

・電子デバイスシステム

増産投資を中心とした半導体製造装置市場の急回復等により前年同期比+105%

・ファインテックシステム

増産投資を中心としたFPD・HD関連製造装置市場の回復等により前年同期比+63%

・科学・医用システム

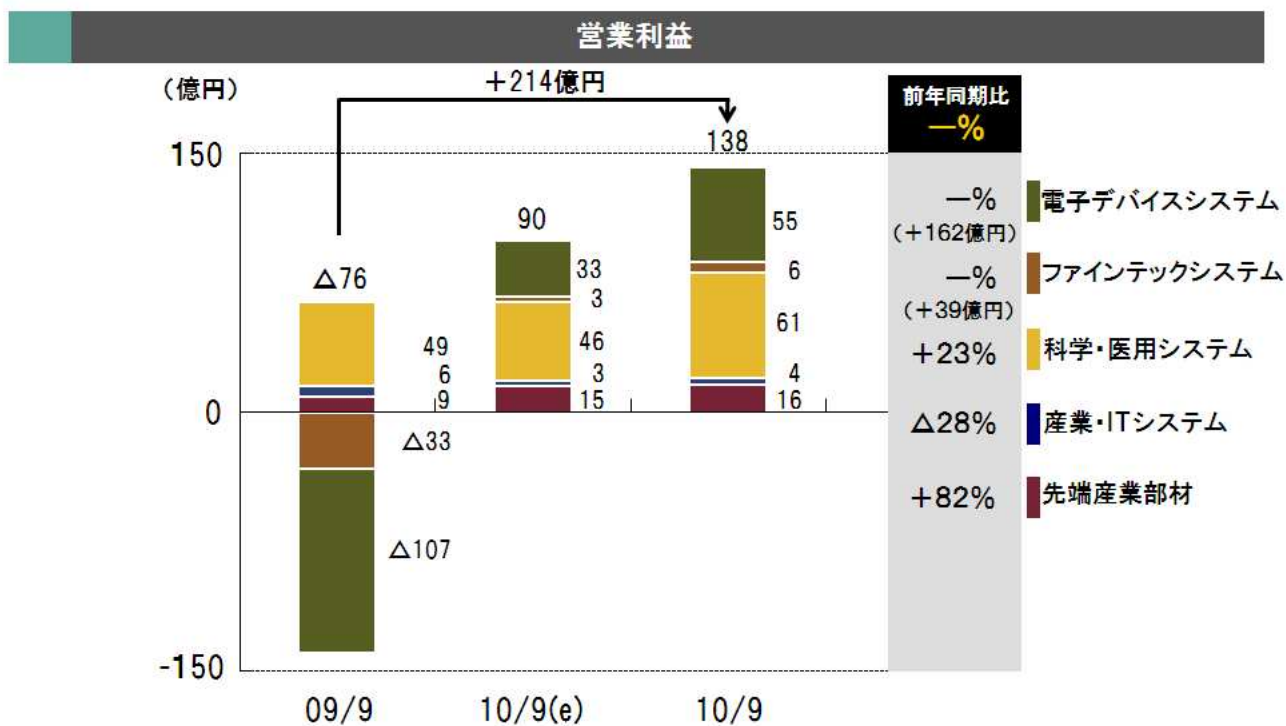
半導体・新エネルギー関連向け解析装置やDNAシーケンサの需要回復等により前年同期比+7%

・産業・ITシステム

米国向け携帯電話は現行モデルの需要は減少するも、LiB自動組立装置や車載用HDD等の回復により前年同期比+1%

・先端産業部材

素材価格の上昇や自動車関連部材の需要回復等により前年同期比+14%



(注)合計にはセグメント間の内部取引の消去等が含まれております。

Copyright©2010 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved.

7

■前年同期比増減説明

・産業・ITシステム

米国向け携帯電話や計装品の売上減少により前年同期比△28%

その他のセグメントでは、売上高とほぼ同様の理由により営業損益が改善

財政状態(貸借対照表[要約])

2010年9月末(億円)

		10/3末比			10/3末比
流動資産	3,328	+80	流動負債	1,556	△2
現預金、関係会社預け金	921	△97	支払手形及び買掛金	1,098	△2
受取手形及び売掛金	1,459	+14	その他	457	+0
たな卸資産	710	+138	固定負債	269	+10
その他	238	+25	退職給付引当金	259	+6
固定資産	856	△7	その他	10	+4
有形固定資産	557	△2	純資産	2,359	+65
無形固定資産	61	+12	株主資本	2,377	+84
投資その他の資産	237	△17	評価・換算差額等	△19	△17
			少数株主持分	1	△2
資産合計	4,184	+73	負債及び純資産合計	4,184	+73

Copyright©2010 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved.

8

■ポイント説明

・流動資産

たな卸資産: 10/3末比 +138億円

(仕掛品 +69億円、積送品 +45億円、その他 +24億円)

・自己資本比率: 56.4%(10/3末比 +0.7%)

・一株当たり純資産: 1,714円43銭(10/3末比 +48円43銭)

財政状態(キャッシュ・フロー計算書[要約])

(億円)		10/1H			10/1H
営業活動による キャッシュ・フロー		+2	財務活動による キャッシュ・フロー		△16
税引前利益		+137	配当金の支払		△14
減価償却費		+41	その他		△2
運転資金		△154	換算差額		△19
法人税等支払・還付額		△19			
その他		△3			
投資活動による キャッシュ・フロー		+84			
有価証券の取得・売却		+0	現金及び現金同等物		10/1H
固定資産取得・売却		△27	期首残高		+902
その他		+111	増減額		+52
フリー・キャッシュ・フロー		+87	期末残高		+954

Copyright©2010 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved.

9

■ポイント説明

・投資活動によるキャッシュ・フロー

その他 +111億円

(事業譲受(半導体後工程装置)による支出 △33億円、

関係会社預け金(3ヶ月超)払い戻しによる収入 +148億円、その他 △4億円)

・10/9末現金および現金同等物(954億円)と

B/S現預金・関係会社預け金(921億円)との差額: 34億円

(預入れ3ヶ月超の定期預金・関係会社預け金 △26億円、その他 +60億円)

Ⅱ 2011年3月期 業績予想概要

(注)YY/MはYY年M月期を表しています。
(e)は、前回予想(2010年7月公表値)
(e1)は、今回予想(2010年10月公表値)

Copyright©2010 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved.

2011年3月期業績予想(ハイライト)①

(億円)

	当年度予想	前年同期比		前回予想比	
		増減額	増減率	増減額	増減率
売上高	6,800	+631	+10%	+100	+1%
営業利益	255	+271	—	+53	+26%
経常利益	260	+265	—	+55	+27%
当期利益	170	+198	—	+44	+35%
一株利益	123円60銭	+144円15銭		+31円99銭	
一株配当	20円00銭	+5円00銭		±00円00銭	
ROE	7.2%	+8.4%		—	
FIV	+39	+161		—	
FCF	+125	△16		+77	

(注)想定レート: 1USD= 87円
1EUR=108円

* 前回予想(2010年7月公表値)

為替変動への対策

■ 想定レート推移

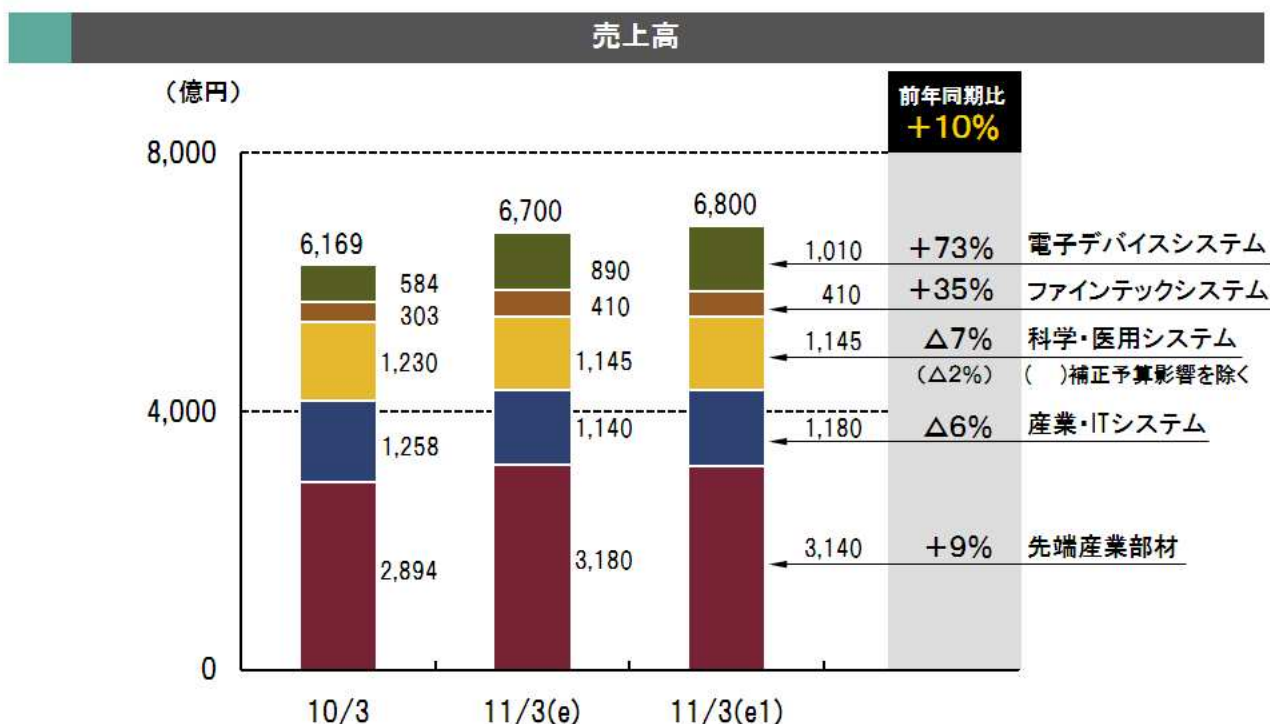
	期初(2010/4)		前回(2010/7)		今回(2010/10)	
	1H	2H	1H	2H	1H [*]	2H
USD	85.00	85.00	90.00	85.00	89.40	87.00
EUR	125.00	125.00	110.00	125.00	114.20	108.00

* 10/1Hは実績レート

■ 為替変動への対策

- ・外貨建取引は成約時に先物為替予約によりヘッジ
→ 10/2Hについては、上記想定レートにより為替リスクは概ね対策済
- ・海外調達・生産を強化

2011年3月期業績予想(セグメント別売上高)



(注) 合計にはセグメント間の内部取引の消去等が含まれております。

Copyright©2010 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved.

13

■ 前年同期比増減説明

・電子デバイスシステム

半導体メーカーの量産投資再開等により前工程・後工程・実装装置共大幅に伸長し、前年同期比+73%を予想

・ファインテックシステム

日本向け液晶関連製造装置(商事品含む)は減少するも、中国向け同装置、HD関連製造装置等への投資が活発化し、前年同期比+35%を予想

・科学・医用システム

解析・汎用分析装置等は、半導体や新エネルギー関連分野での投資回復が見込まれるものの、09年度補正予算案件の反動や円高の影響等により、前年同期比△7%を予想
(09年度補正予算影響除く: 前年同期比△2%)

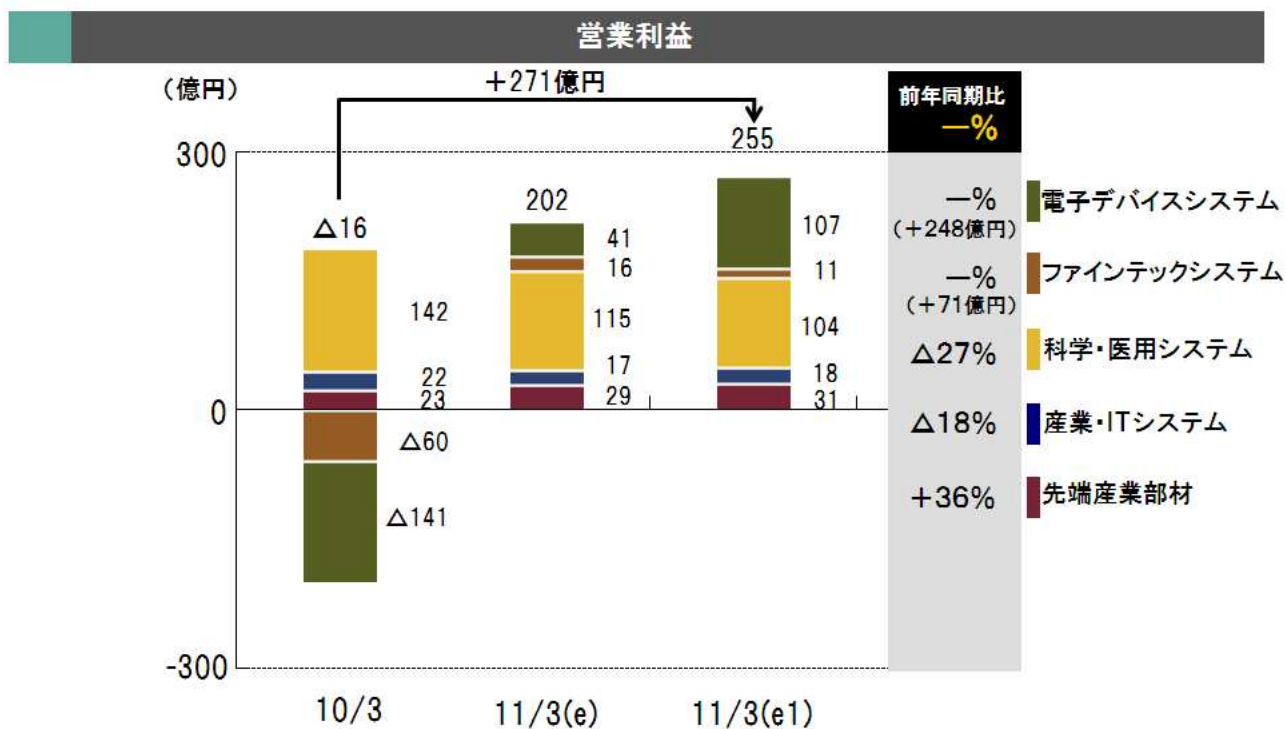
・産業・ITシステム

環境適合車関連の組立装置・製品や設計・製造ソリューション等は回復するも、米国向け携帯電話は、現行モデルの需要減等により、前年同期比△6%を予想

・先端産業部材

素材価格上昇や、自動車関連部材・電子デバイス材料の需要回復等により、前年同期比+9%を予想

2011年3月期業績予想(セグメント別営業利益)



(注)合計にはセグメント間の内部取引の消去等が含まれております。

Copyright©2010 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved.

14

■前年同期比増減説明

各セグメント共、売上高とほぼ同様の理由により営業損益が増減すると予想

半導体デバイス・製造装置市場動向

半導体デバイス市場

- モバイルPCやスマートフォンなどモバイル機器が好調のため、10年度半導体デバイス市場は回復(09年度:251B\$→10年度:295B\$) PCは10年度下期一時的な在庫調整が行われるが、新興国・企業向けが下支えし長期化せずボトムアウト
- 11年度もNAND、MPU、ASSPとも成長の見通し。DRAMは価格低下により販売高は今年度比△5～△7%の見込みだが、ビット成長率は引き続き高くDRAM増産は継続

半導体製造装置市場

- 10年度上期に市場は急回復し、10年度は対前年度比+87%の見通し
- 10年度後半～11年度始めに一時的なディップの可能性あるが、長期化せず11年度も10年度と同等の市場規模を見込む
- 最先端DRAM(3Xnm)、NAND(2Xnm)、ロジック(2Xnm)の量産移行への投資が進み、先端メモリー、ファウンドリ中心に新規ファブ建設予定

Copyright©2010 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved.

15

■ 半導体デバイス・製造装置市場動向

メモリーは単価ダウンに対応するために、微細化への量産投資が進行し、来年前半には新設ラインへの投資も複数計画されている

引き続き、スマートフォン、タブレットPC、3D・高精細対応製品が牽引し、新興市場の拡大と合わせ一時的な在庫調整局面は比較的早期に解消され、マクロ的には来年にかけて半導体デバイス・半導体製造装置市場ともにプラス成長を維持

但し、グローバルな金融市場と相互供給・相互依存した多極化世界の進展により、世界経済の動向にはこれまで以上の注視が必要

半導体デバイスの微細化動向について

■微細化目的の変化

- ・従来 高性能化+低コスト化
 - ・今後 低コスト化+小型化
- 先端NAND、ロジック、DRAMで微細化加速

■次世代リソグラフィーの動向

- ・本命はEUV(極遠紫外線)リソグラフィー
但し、実用化は遅延する見込み
- ・当面は光リソ+ダブルパターニング(DP)
DPはパターンピッチ1/2化が可能
DPプロセスの技術革新の可能性有

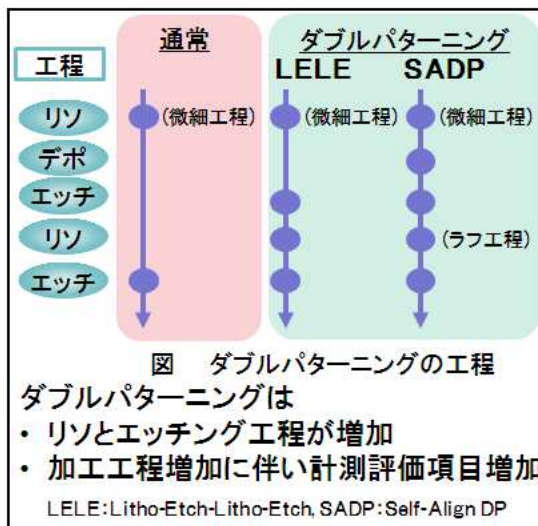
■当社は次世代微細化へのソリューションを開発中

- ・DP用エッチング装置
- ・DP用チップ内合わせ誤差測定:CD-SEM
(IBMとの共同研究成果)

表 微細化が加速(NANDフラッシュ) 単位:nm

年	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ITRS' 09 Flash hp	32	28	26	23	20	18
先端Flash 微細化計画	32	27~21		18~16		14~11

ITRS: International Technology Roadmap for Semiconductors



Copyright©2010 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved.

16

■半導体デバイスの微細化動向について

微細化の目的が従来と変わり、先端デバイスメーカーの微細化が再加速

従来の微細化目的: 高性能化(高速化、低電圧・低消費電力化)とチップ面積縮小によるコストダウン
 今後の微細化目的: 低コスト化とチップの小型化

従来の液浸ArF(波長193nm)の高NA化に限界が見え、次世代リソグラフィーへの関心が高まる

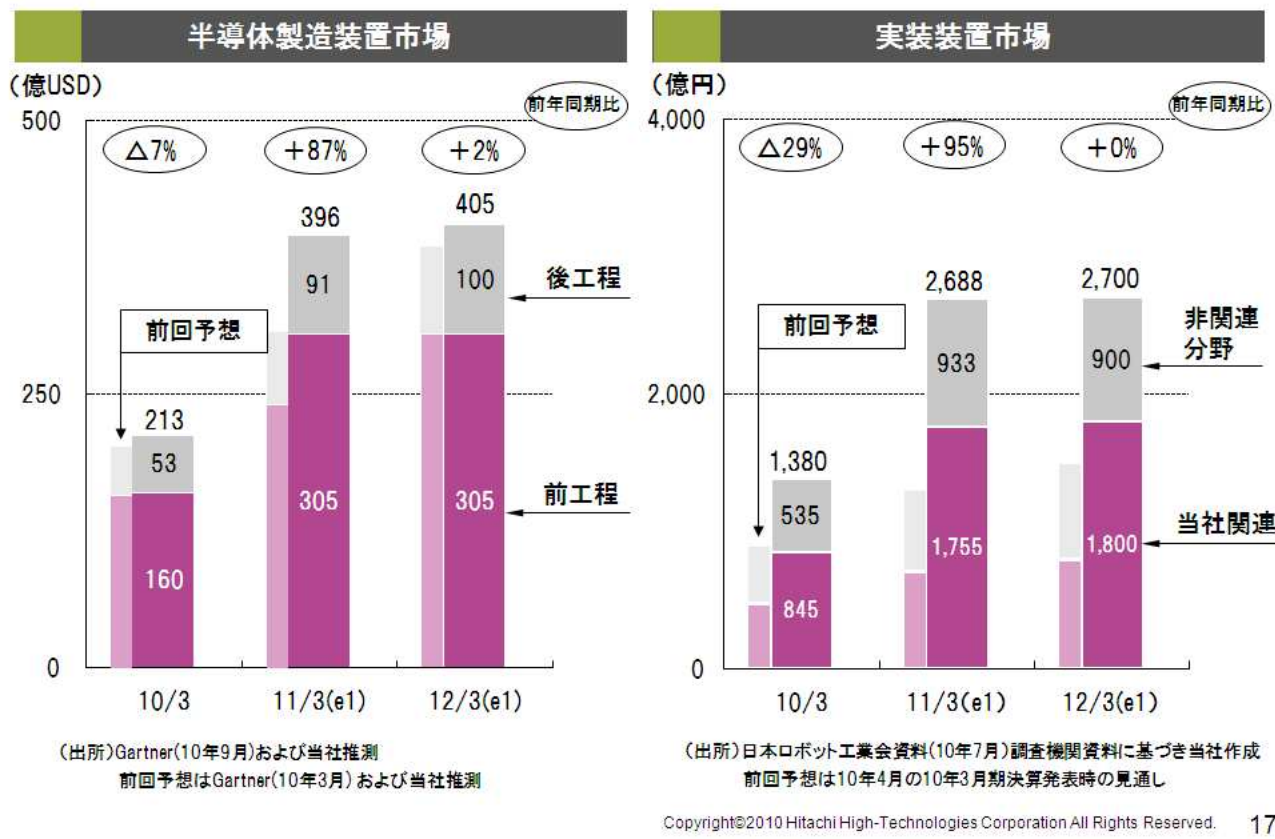
本命はEUV(極遠紫外線 波長13nm)リソ。共同開発コンソーシアムにより精力的に開発が進められているものの、再加速した微細化計画とはまだ大きな乖離があり
 当面は、液浸リソにダブルパターニング(DP)を組合わせた露光方法が採用される見通し
 DPプロセスを採用すると、パターンピッチを1/2まで縮小することができる
 更に、レイアウトの最適化等を含めたDPプロセス技術革新により、液浸ArF露光が更に延命する可能性もある

当社では、次世代リソグラフィー用各種ソリューションを提供し、先端デバイスメーカーのコスト削減に貢献すると共に、事業拡大を図る

(例) ・ダブルパターニング用エッチング装置

・CD-SEMによるダブルパターニング用チップ内合わせ誤差測定

ダブルパターニングは合わせ誤差管理が一段と厳しくなるが、従来の光学式合わせ誤差測定では、チップ内の合わせ誤差の測定は困難



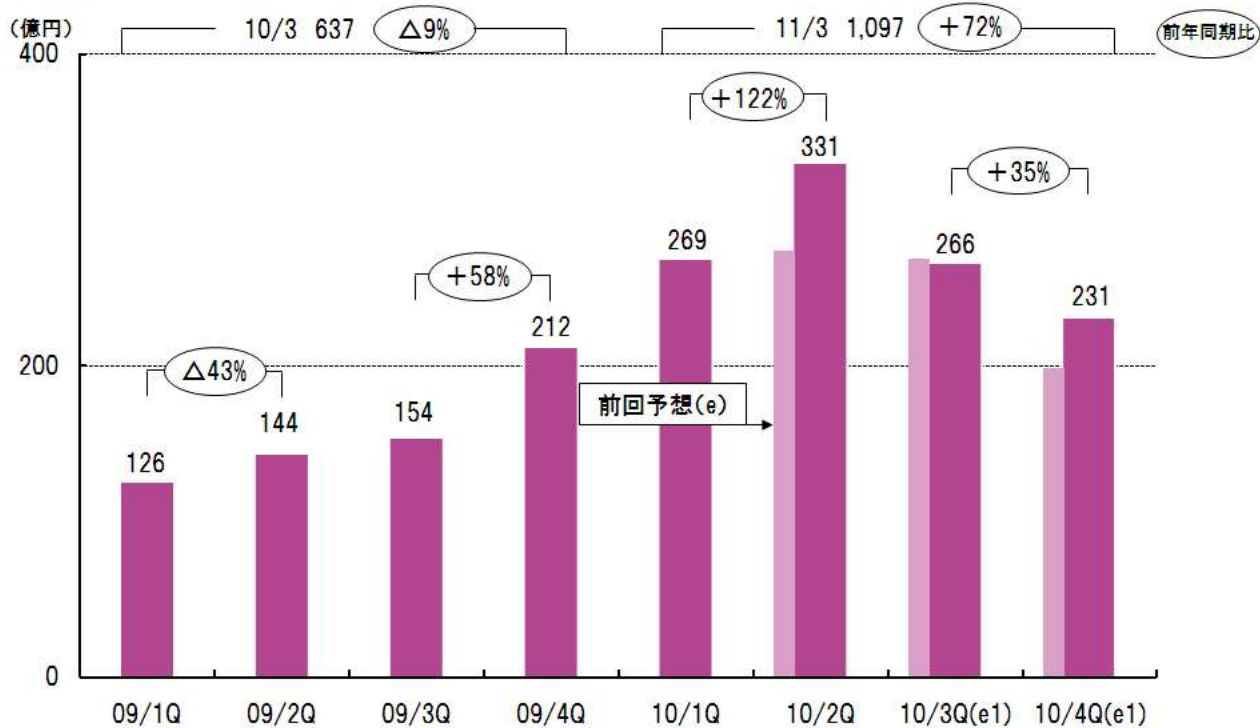
■半導体製造装置市場の状況説明

- ・10年度: 上期は、当初の予想を上回る回復を示し、半導体製造装置市場についても、メモリーメーカーやファウンドリをはじめとした大型投資により大きく回復
下期は、PC市場においてネガティブな動きはあるものの、MPU、NAND、ファウンドリを中心に上期と同程度の投資が期待できるため、+87%の大幅な成長を予想
- ・11年度: 1Qは調整局面に入る可能性があるが、年度半ばより新規ファブへの投資も開始され、半導体製造装置市場は10年度と同程度の市場規模を予想
後工程組立装置市場はDRAM、NAND、MPU、ASSPともにチップ数は増加傾向にあるため、装置台数の増加が見込まれる

■実装装置市場の状況説明

- ・10年度: 2Qをピークに年末にかけ需要回復ピッチが弱まるものの、通年では、前年同期比+95%の大幅な成長を予想
- ・11年度: 前半は、10年度の大幅投資の反動で前年度比やや減少から横ばいを予想
ただし、3D対応製品(液晶テレビに加えパソコンやデジカメなど)、スマートフォン、タブレットPC(電子書籍)などが牽引し、年度後半は復調
通年では前年度並みの市場規模を予想、高速機の需要が高まる傾向へ

受注高の推移



18

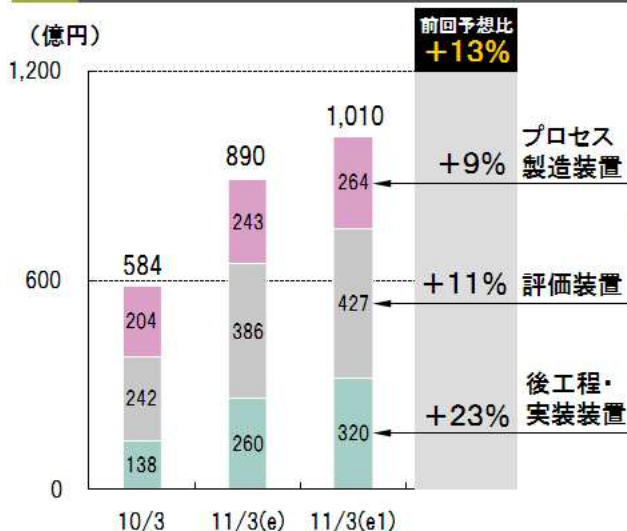
■受注高の推移

- ・10/上:ファウンドリ・メモリーメーカーおよびアジア地区の後工程・実装メーカーを中心とした増産対応の設備投資再開を受け、受注は09年度後半から引き続き伸長
特に2QではMPUを中心とした前工程装置、およびNAND用ボンダの受注が大幅伸長したことにより、前年同期比+122%、前期比+64%
- ・10/下:2Qに比べ減少するものの、11年度に向けてライン新設も含めた微細化投資が予想され、3、4Qも1Q並みの水準を維持、前年同期比+35%、前期比△17%を予想

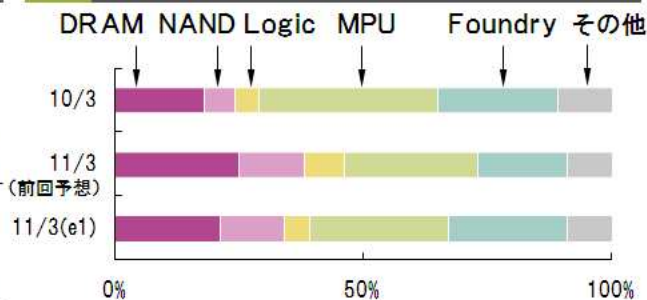
今後の取り組み

1. 前工程・後工程装置:成長分野の取り込みと微細化への対応を促進し受注を確保
2. チップマウンタ:新規顧客の開拓と現ユーザーのCS向上による市場成長以上のシェアアップ

主要製品群別売上高の推移



前工程装置 分野別売上高比率



(注) 前回予想は、10年4月の10年3月期決算発表時の見通し

09年度:市場全体が縮小するなか、MPUメーカーからの売上確保、後半はファウンドリも好調
 10年度:MPU、ファウンドリは引き続き堅調
 DRAM、NANDメーカーの投資再開により相対的に比率が上昇

Copyright©2010 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved.

19

■今後の取り組み

1. 前工程・後工程装置:成長分野の取り込みと微細化への対応を促進し受注を確保
 →先端デバイスプロセス向け新製品の投入、生産性向上・顧客コストの最小化への貢献により受注の確保を図る
2. チップマウンタ:新規顧客の開拓と現ユーザーのCS向上による市場成長以上のシェアアップ
 →10/下に専門部署を設立し、大手顧客攻略を促進しシェアアップを図る

■10年度 前回予想比増減説明

プロセス製造装置

- ・MPUメーカー需要増等により、前回予想比+9%

評価装置

- ・中国を始めアジア地区全般に市場が拡大したことにより、前回予想比+11%

後工程・実装装置

- ・中国を中心に引き続き投資は堅調
- ・液晶テレビ、スマートフォン、PC関連を中心に増産基調が継続し、前回予想比+23%

■10年度 前工程装置 分野別売上高比率

メモリーメーカーの大型投資再開等により、相対的にDRAM・NANDの割合が上昇

FPDパネル・HDの動向について

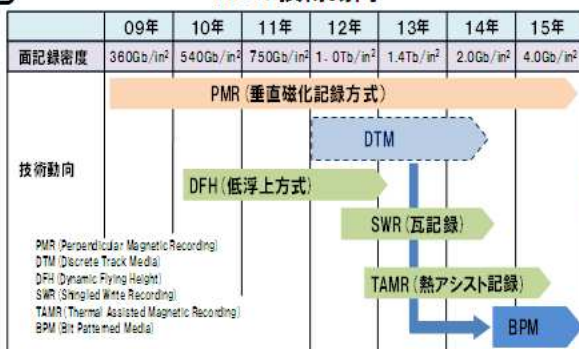
■ FPDパネル

FPDパネルの動向	技術トレンド	当社の対応
タッチパネル製品の増加	・静電容量方式の増加で微細パターン化進展	・露光装置 ITOアライメント機能の追加 重ね合せ精度の向上
高精細化の進展	・フルHD ⇒ 2k4k ⇒ 4k8k	
3D TVの本格普及	・高開口率化(光配向/PSA/COA) ・高速化(240Hz/480Hz駆動)	・実装装置 パネル補正機能の追加 新接合方式の導入
有機ELパネルの増加と大型化	・大型マザーガラス対応ライン	・有機EL製造装置への新規参入

PSA: Polymer Sustained Alignment COA: CF on Array ITO: Indium Tin Oxide

■ HD

HDの技術動向



Copyright©2010 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved.

20

■ FPDパネル・HDの動向について

FPDパネル

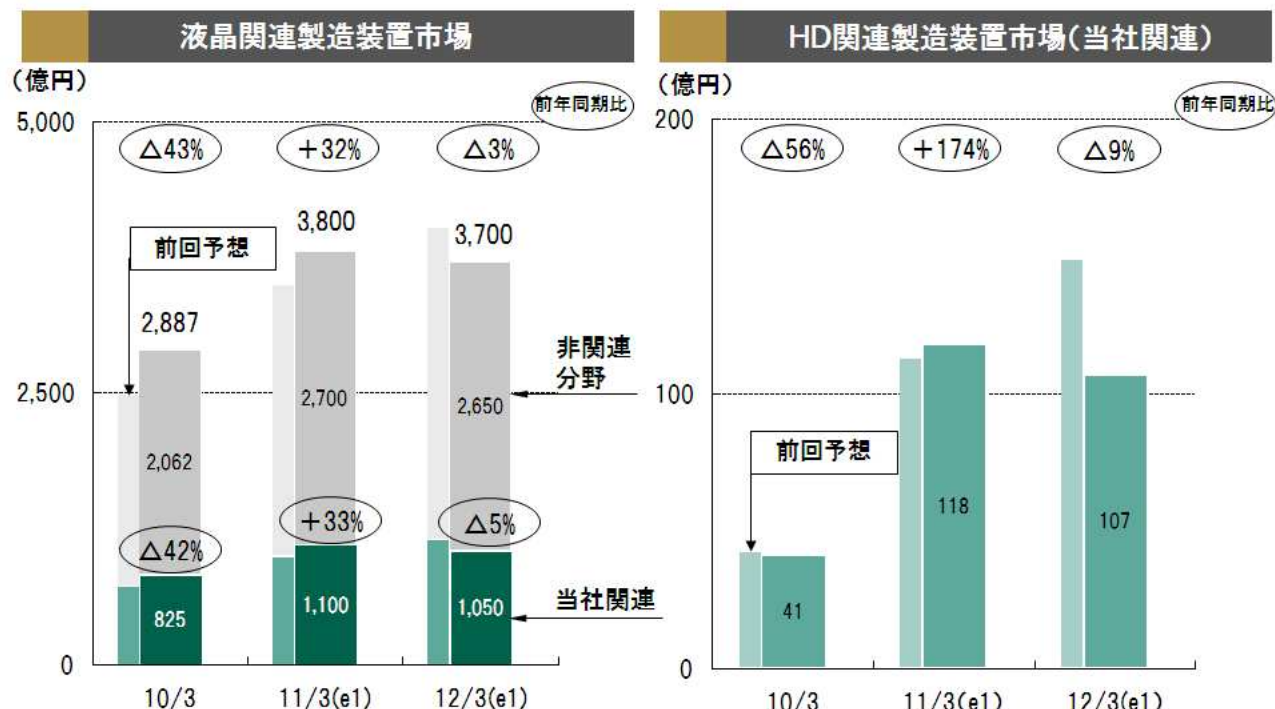
- ・タッチパネル製品の増加: スマートフォンからタブレットPCに広がり
→露光装置のタッチパネル対応
- ・高精細化の進展
- ・3D TV対応
→露光装置の解像度向上
→実装装置のファインピッチ及び高スループット対応
- ・有機ELパネル
→大型対応の有機EL製造装置の開発

HD

HDDの新技术であるDTM技術の導入計画は、12年量産として進められていたが、コスト・技術的な課題等で後退し、次世代技術であるBPM技術の開発にシフト

代替技術への対応装置展開として;

1. DFH技術: 光学式メディア検査装置(低浮上対応・光学方式による全面検査対応)
2. SWR(瓦記録)技術: 光学式メディア検査装置(低浮上対応・光学方式による全面検査対応)
3. TAMR技術:
 - ディスク関連→光学式メディア検査装置(低浮上対応・光学方式による全面検査対応)
 - ヘッド関連→TAMR対応ヘッド関連検査装置(レーザー制御対応)
4. BPM技術:
 - ディスク関連→インプリント装置(インプリント技術対応)
 - 光学式メディア検査装置(低浮上対応・光学方式による全面検査対応)



(出所)SEAJ(10年7月)日本製装置市場データに基づき当社にて推測
(注)前回予想は、10年4月の10年3月期決算発表時の見通し

(出所)当社推測

Copyright©2010 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved.

21

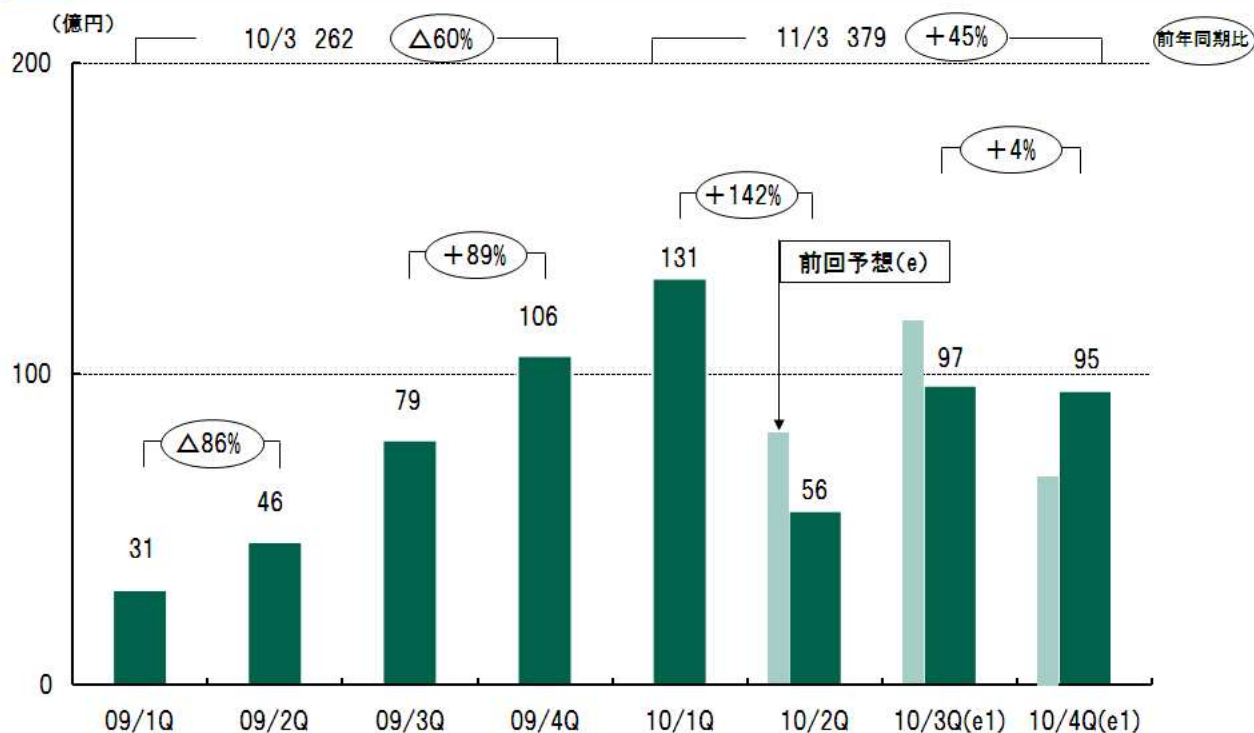
■液晶関連製造装置市場概況

- ・10年度:中国パネルメーカーの他、日本、韓国、台湾の大手パネルメーカーが中国や新興国の需要を見込んで新パネルラインへの装置導入を進めることから、前年度比+32%の大幅成長を予想
- ・11年度:10年度後半から11年度前半の需要が不透明なことに加え、中国案件の計画遅延等により、前年同期比△3%を予想

■HD関連製造装置市場概況

- ・10年度:法人向けPC用途のHDD需要が拡大。ディスク・サブストレート増産投資により、前年比+174%の大幅成長を予想
- ・11年度:HDDの新技术であるDTMの製品化が、次世代技術であるBPMの開発にシフトした影響で、前年同期比△9%を予想

受注高の推移



Copyright©2010 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved.

22

■受注高の推移

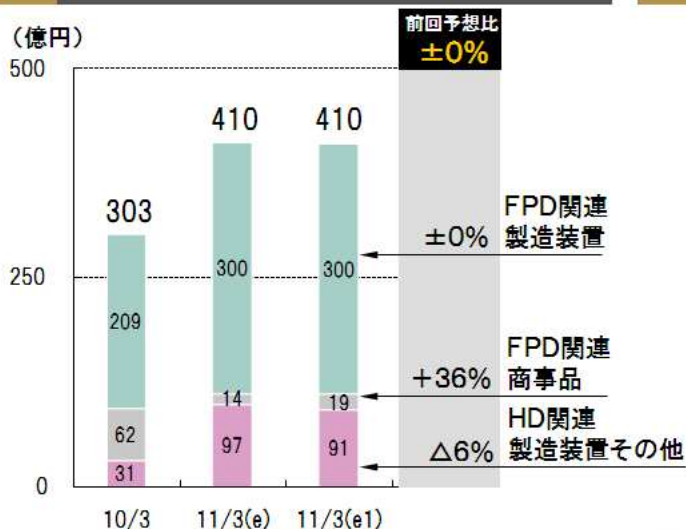
中国前工程投資案件の計画遅延により、受注が後半へシフト

- ・10／上: 中国大陸・韓国の液晶前工程の設備投資やHD関連の増産設備投資により、前年同期比+142%、前期比+1%
- ・10／下: 液晶の前工程投資継続に加え、後工程投資がスタートすることにより、前年同期比+4%、前期比+3%を予想

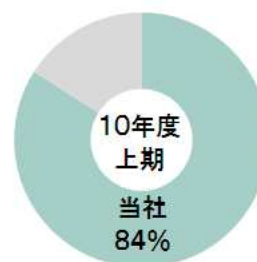
今後の取り組み

1. 製品競争力の向上による業界トップの地位確保(液晶露光装置・HD検査装置)
2. 新製品・新規事業開発の推進(有機EL製造装置)
3. 市場変動に強い事業体制への転換(グローバル調達加速)

主要製品群別売上高の推移



カラーフィルタ用露光装置シェア(G8)



(出所)当社推測

・09年度までの累計シェアは68%

・マスク補正機構による細線BM対応とCOA対応により10/上のシェア向上

BM:Black Matrix

Copyright©2010 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved.

23

■今後の取り組み

1. 製品競争力の向上による業界トップの地位確保
 - 1) 液晶露光装置
10/上はG8パネルライン投資で受注獲得
引き続き基本性能向上とコスト低減によりトップシェアを確保
 - 2) HD検査装置
10/上はディスクおよびサブストレートの増産投資で受注獲得
サブストレート用表面検査機は性能を向上させた新製品を投入予定
2. 新製品・新規事業開発の推進
 - 1) 液晶関連 新型実装装置の市場投入
 - 2) HD関連 新コンセプト製品の市場投入
 - ①ヘッド素子形状検査装置
 - ②光学式メディア検査装置
 - 3) 新規事業 有機EL製造装置の11年度事業化
3. 市場変動に強い事業体制への転換
 - 1) 海外調達/生産を視野に生産最適体制を構築
 - 2) グローバル営業・サービス体制の最適化

■10年度 前回予想比増減説明

FPD関連製造装置

・液晶関連は装置の価格低減圧力が強いものの、ほぼ予定通りで推移

HD関連製造装置その他

・HD関連はディスク・サブストレートの増産投資に伴う検査装置の販売は好調なるも、DTM関連装置の減少等により、前回予想比△6%を予想

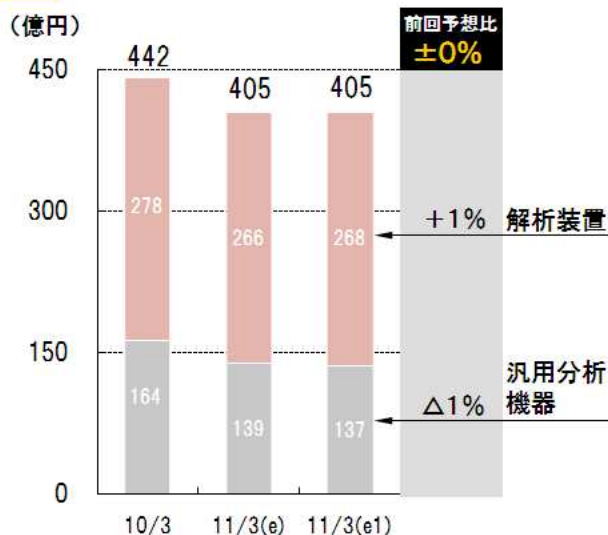
今後の取り組み

1. 分析関連事業:成長市場(LiB、PV、LED、製薬等)への積極的な拡販

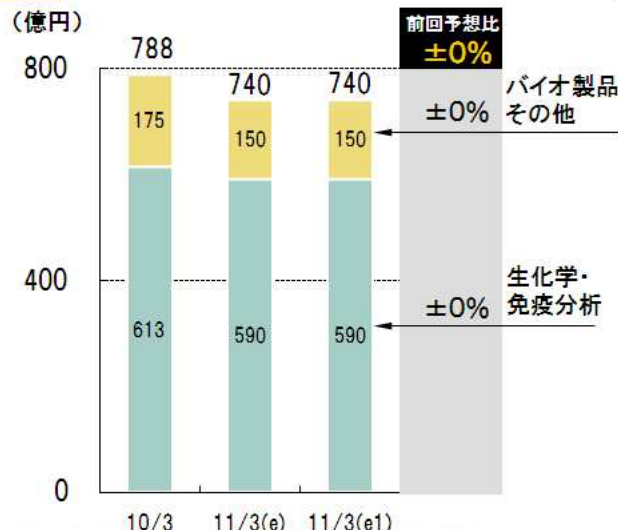
2. バイオ・メディカル事業:国内外の有力メーカーとのSCBの推進

*SCB: System Collaboration Business

分析関連事業 売上高の推移



バイオ・メディカル事業 売上高の推移



Copyright©2010 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved.

24

■今後の取り組み

1. 分析関連事業:成長市場(LiB、PV、LED、製薬等)への積極的な拡販

→ アプリケーションおよびソリューションの開発・充実による成長市場への積極的な拡販

2. バイオ・メディカル事業:国内外の有力メーカーとのSCBの推進

→ 海外パートナーとの連携強化による新大型生化学・免疫分析システムの拡販

中国および日本における装置+試薬のシステム販売の推進

DNAシーケンサのアプライド市場(DNA鑑定・診断等)への対応と次世代装置開発の推進

■前回予想比増減説明

分析関連事業

・円高の進行により価格競争が激化するも、設備投資が旺盛な新エネルギー市場や、需要が伸長している材料関連市場への積極的な拡販により、前回予想比横ばいを予想

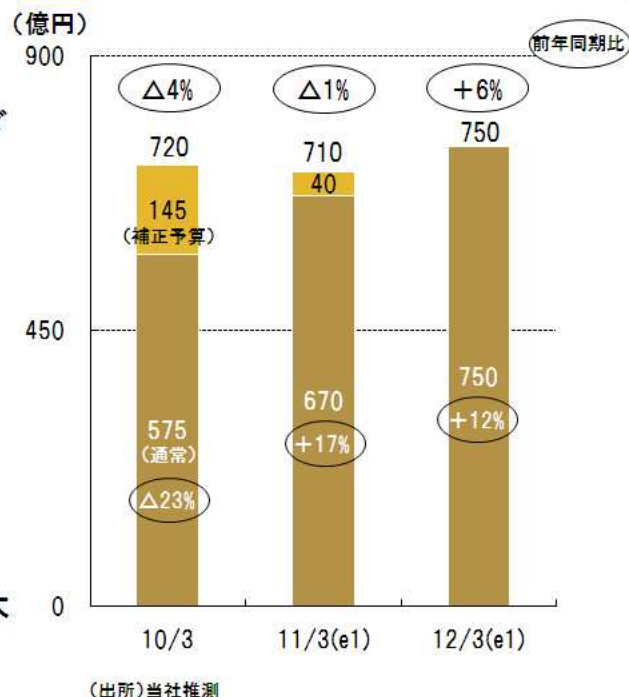
バイオ・メディカル事業

・円高と米国市場の景気低迷等の影響はあるものの、アジア向けの生化学分析装置の販売好調とDNAシーケンサの新製品投入効果等により、前回予想比横ばいを予想

解析装置市場の注力分野と今後の取り組み

- 環境・新エネルギー(LiB・PV等)関連市場
優位化技術である観察試料酸化防止ホルダなど新アプリケーション・アクセサリを活用した提案営業の推進
- 半導体デバイス関連市場
超高分解能FE-SEMおよびSTEMの拡販
- バイオ・食品・化学市場
イージーオペレーションを実現した新型バイオ分野向けTEMの市場投入による拡販
- 全般
小中学校から民間企業の品質管理まで、新型卓上顕微鏡による電子顕微鏡市場の裾野拡大

解析装置市場



Copyright©2010 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved.

25

■ 解析装置の市場概況

環境・新エネルギー関連市場の設備投資活況や材料市場の投資再開等により、通常物件は回復基調にあるものの、09年度に国内・米国の緊急経済対策の補正予算が執行された影響により、10年度の全体市場規模としては、ほぼ横ばいを予想

■ 注力分野と今後の取り組み

環境・新エネルギーおよび液晶関連市場

活況を呈しているLiB・PVなどの新エネルギー市場および液晶関連市場の新材料開発用に試料酸化防止ホルダ(雰囲気遮断ホルダ)を活かした提案営業を行う

半導体デバイス関連市場

半導体市場の投資再開に伴い、微小領域の組成分析用ハイエンド機の需要増加を見込み、超高分解能FE-SEM(電界放出型走査電子顕微鏡)およびSTEM(走査透過電子顕微鏡)の拡販を行う

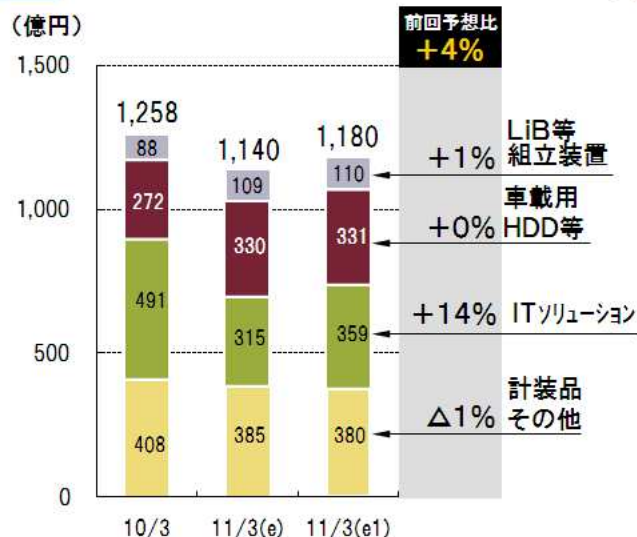
バイオ・食品・化学市場

本体とカメラの操作の統合などのシンプルなオペレーションを実現、通常の明るい部屋で高コントラストの観察を可能にした新型デジタルTEM(透過電子顕微鏡)の拡販を図る

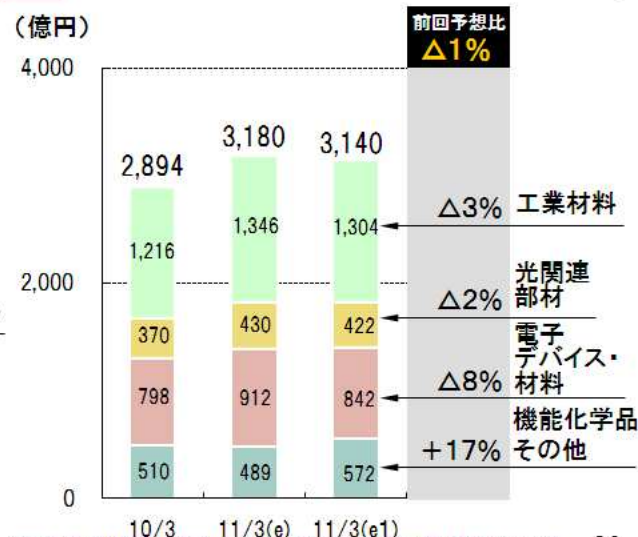
今後の取り組み

1. 太陽電池関連事業の拡大
2. アジアベルト地帯新興国での開発加速

産業・ITシステム 売上高の推移



先端産業部材 売上高の推移



Copyright©2010 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved.

26

■今後の取り組み

1. 太陽電池関連事業の拡大
→太陽電池用部材の開発促進
太陽電池セル・モジュールメーカーへの新規部材の開発
2. アジアベルト地帯(※)新興国における開発加速
→インドネシア・インドでの新エネルギー・水関連EPC (Engineering Procurement Construction)
ビジネス開発促進
→サウジアラビア／リヤドに人材を派遣、新エネルギー・社会インフラビジネスの開発促進
(※)アジアベルト地帯・・・日本からアラビア半島に至るその間のアジア沿岸部24カ国・地域

■10年度 前回予想比増減説明

産業・ITシステム

- ・LiB等組立装置は、国内の低迷が予想されるものの、環境対応および海外設備投資の取り込みにより、横ばいを予想
- ・車載用HDD等は、エコカー減税の反動により市場は縮小が予想されるが、欧州向け新規アカウントの獲得による増加を見込み、前回予想比横ばいを予想
- ・ITソリューションは、米国向け携帯端末の新機種が順調に立ち上がったことにより、前回予想比+14%を予想

先端産業部材

- ・工業材料は、スマートフォン対応部品、建設機械部材、および結晶系太陽電池部材が伸びるものの、エコポイント終了による反動により、自動車・家電・TV部材の減少を見込み、前回予想比Δ3%を予想
- ・光関連部材は、光通信分野において輸入ビジネスが堅調に推移したものの、海外向け薄膜系太陽電池製造装置、パネル、およびモジュールが円高により減少、前回予想比Δ2%を予想
- ・電子デバイス・材料は、シリコンウエーハ、液晶関連材料市況の軟化、および一部商権の返上により、前回予想比Δ8%を予想

Ⅳ 参考:データ集

(注)YY/MはYY年M月期を表しています。

Copyright©2010 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved.

四半期業績の推移

(億円)

			09年1Q	09年2Q	09年3Q	09年4Q	10年1Q	10年2Q	
売上高／営業利益	電子デバイスシステム	売上高	105	129	141	209	169	311	
		営業利益	△48	△59	△24	△11	7	48	
	ファインテックシステム	売上高	59	48	53	143	67	108	
		営業利益	△14	△19	△10	△17	△1	7	
	科学・医用システム	売上高	242	301	266	422	275	306	
		営業利益	21	28	32	61	30	31	
	産業・ITシステム	売上高	275	309	284	391	296	295	
		営業利益	△3	8	0	16	△3	7	
	先端産業部材	売上高	661	730	732	771	802	777	
		営業利益	7	2	7	8	11	5	
	その他・消去又は全社	売上高	△16	△25	△24	△35	△24	△29	
		営業利益	△1	1	△1	△1	△1	△4	
	合計		売上高	1,325	1,492	1,451	1,901	1,585	1,768
			営業利益	△38	△38	4	56	43	95
経常利益			△32	△37	8	57	50	93	
当期利益			△20	△33	△3	28	35	63	

Copyright©2010 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved.

28

■設備投資額・減価償却費・研究開発費

(億円)

	09/1H	10/1H	前年 同期比	10/3	11/3(e)	前年 同期比
設備投資額	52	40	△23%	94	114	+21%
減価償却費	46	41	△10%	96	96	+0%
研究開発費	94	103	+10%	193	224	+16%

(注)設備投資額は取得ベースにて記載

■地域別売上高

(億円)

		日本	北米	欧州	アジア	中国大陸	その他	計
09/1H	売上高	1,325	315	355	766	347	56	2,817
	構成比率	47.1%	11.2%	12.6%	27.2%	12.3%	2.0%	100.0%
10/1H	売上高	1,475	295	356	1,172	517	55	3,353
	構成比率	44.0%	8.8%	10.6%	34.9%	15.4%	1.6%	100.0%

主要製品群別売上高の状況

	09年1Q	09年2Q	09年3Q	09年4Q	10年1Q	10年2Q	(億円)
電子デバイスシステム	105	129	141	209	169	311	
プロセス製造装置	65	33	57	49	32	77	
評価装置	23	55	49	115	79	125	
後工程・実装装置	17	40	35	45	58	109	
ファインテックシステム	59	48	53	143	67	108	
FPD関連製造装置	52	42	48	131	56	78	
HD関連製造装置その他	6	6	5	12	11	30	
科学・医用システム	242	301	266	422	275	306	
汎用分析機器	29	39	40	66	27	44	
解析装置	31	67	46	124	36	79	
生化学・免疫分析装置	144	152	137	180	162	139	
バイオ製品その他	38	42	43	53	49	44	
産業・ITシステム	275	309	284	391	296	295	
LiB等組立装置	15	19	16	38	35	21	
車載用HDD等	60	68	68	75	75	82	
ITソリューション	114	123	106	148	103	99	
計装品その他	85	99	94	130	83	93	
先端産業部材	661	730	732	771	802	777	
工業材料	278	287	326	325	336	339	
光関連部材	70	93	105	102	99	81	
電子デバイス・材料	209	205	203	181	238	219	
機能化学品その他	104	145	98	162	129	138	

(注) 科学・医用システムの2009年度4Q売上高のうち、汎用分析機器66億円および解析装置124億円は、項目間で修正を行い、2010年7月公表より5億円増減しております。

Copyright©2010 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved.

30

<資料取り扱い上の注意>

- ① 本プレゼンテーションで述べられている決算概要及び業績予想は、注記がある場合を除き、すべて連結であり、億円未満を四捨五入しています。
- ② YY/M(e)はYY年M月期予想を表しています。
- ③ 本プレゼンテーションで述べられている装置・機器等の市場情報については注記がある場合を除き、すべて世界市場です。
- ④ 本プレゼンテーションで述べられている将来の当社業績に関する予想は、現時点で知りうる情報をもとに策定されたものです。当社の参画する産業界はテクノロジーの変化が速く、競争の激しい産業です。また、世界経済、半導体市況、為替相場など、当社の業績に直接的・間接的に影響を与える様々な外部要因があります。したがって、今後、当社の業績が本プレゼンテーションと異なる可能性があることとお含みおきください。但し、大きな変動がある場合は、証券取引所の適時開示規則及び当社の自発的判断等に基づき、その都度公表していく所存です。

また、この資料は投資判断の参考となる情報の提供を目的としたもので、投資勧誘を目的として作成したものではありません。銘柄の選択、投資の最終決定は、ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

END

2011年3月期第2四半期 決算説明会

お問合せ先
社長室 広報・IRグループ 部長代理 加藤 弘之
TEL:03-3504-5138 FAX:03-3504-5943
E-mail:kato-hiroyuki@nst.hitachi-hitec.com

日立ハイテック

最先端を、最前線へ。

Copyright©2010 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved.